



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110318001A

2011 年 4 月 27 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

PWR SOP/PDIP パッケージ 一部製品 グリーン化対応モールド樹脂変更予定取消のご案内

(初版 PCN20110318001 2011 年 3 月 30 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更取消についての連絡になります。本変更は実施されません。詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日**以内に通知確認のご連絡をお願いいたしますお客様の受領連絡は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)		☐ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	初版連絡の下記変更内容について変更取消の連絡になります。 PWR SOP/PDIPパッケージ 一部製品 グリーン化対応モールド樹脂変更 現行 : 部材型番 450260, 450346 (グリーン化未対応) 変更後: 部材型番 450042 (グリーン化対応)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	7月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、2011年3月30日発行 初版 PCN20110318001にて連絡しました下記変更予定について、変更取消の連絡になります。

弊社 PWR (パワーマネジメント) SOP (7DUA, 10DVS) /PDIP (7NVA, 10NVE) パッケージ 一部製品について、現行 部材型番: 450260, 450346 グリーン化未対応モールド樹脂を適用し製造しておりますが、高曲げ強度によるパッケージ堅牢性向上の為に、部材型番: 450042 グリーン化対応モールド樹脂に変更する予定です。HANA社(タイ)サイトにおいて、450042 グリーン化対応モールド樹脂による製造は認定しています。下記信頼性試験結果(2008年6月16日終了)を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

モールド樹脂 部材型番

現行

450260, 450346

変更後

450042

理由: 高曲げ強度によるパッケージ堅牢性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
DCP010505BP	DCP010512DBP-U/700	DCP020503P	DCR011205P	DCV010514CP-U
DCP010505BP-U	DCP010512P-U-7	DCP020505P	DCR012403P	DCV010514CP-U/700
DCP010505BP-U/700	DCP010515BP	DCP020507P	DCR012405P	DCV010514CP-U/7E4
DCP010505BP-U/7E4	DCP010515BP-U	DCP020509P	DCR021205P	DCV010515DP
DCP010505BP-UE4	DCP010515BP-U/700	DCP020515DP	DCR021205P-U	DCV010515DP-U
DCP010505DBP	DCP010515DBP	DCP021205P	DCR022405P	DCV010515P
DCP010505DBP-U	DCP010515DBP-U	DCP021205PE4	DCR022405P-U	DCV010515P-U
DCP010505DBP-U/700	DCP010515DBP-U/700	DCP021207P-U-7	DCR022405P-U/700	DCV011512DP
DCP010505DBP-U/7E4	DCP011512DBP	DCP021207P-U-7/700	DCV010505DP	DCV011512DP-U
DCP010505DBP-UE4	DCP011512DBP-U	DCP021212DP	DCV010505DP-U	DCV011512DP-U/700
DCP010507DBPE4	DCP011512DBP-U/700	DCP021212P	DCV010505P	DCV011515DP
DCP010507DBP-U/7E4	DCP011515DBP	DCP021515P	DCV010505P-U	DCV011515DP-U
DCP010507DBP-UE4	DCP011515DBP-U	DCP021515PE4	DCV010505P-U/700	DCV011515DP-U/700
DCP010512BP	DCP011515DBP-U/700	DCP022405DP	DCV010505P-U/700E4	DCV012405P
DCP010512BP-U	DCP012405BP	DCP022405P	DCV010512DP	DCV012405P-U
DCP010512BP-U/700	DCP012405BP-U	DCP022415DP	DCV010512DP-U	DCV012405P-U/700
DCP010512DBP	DCP012415DBP	DCR010503P	DCV010512DP-U/700	DCV012415DP
DCP010512DBPE4	DCP012415DBP-U	DCR010505P	DCV010512P	DCV012415DP-U
DCP010512DBP-U	DCP012415DBP-U/700	DCR011203P	DCV010512P-U	DCV012415DP-U/700

製品表示

今回の変更に伴い、出荷梱包箱のラベル表示が鉛フリー/グリーン化対応を明示する為に下記の様になる予定です。



図 1. 出荷ラベルの表示例

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 2 月	終了	2011 年 5 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	DCP010505BP	-	-	
Assembly Site:	HNT	Package/Code/Pins:	PDIP/NVA/7	
Mount Compound:	400018	Mold Compound:	450042	
Bond Wire:	1.2 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size
**Steady-state Life Test	100C, 168, 500, 1000, 2000 Hrs			77
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs			77
**Biased HAST	85C/85%RH, 500, 1000 Hrs			154
**Autoclave	121C, 96 Hrs			77
**T/C	-40C/125C, 250, 500, 1000 Cyc			77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification			per spec
Th/Shock	-40C/125C, 250, 500, 1000 Cyc			77
X-ray	top side only			5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C			24
Notes: ** Preconditioning sequence. JEDEC L-3/260C				

信頼性試験計画

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 2 月	終了	2011 年 5 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	DCP010512DBP	-	-	
Assembly Site:	HNT	Package/Code/Pins:	PDIP/NVA/7	
Mount Compound:	400018	Mold Compound:	450042	
Bond Wire:	1.2 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test		Condition / Duration		Sample Size
**Steady-state Life Test		100C, 168, 500, 1000, 2000 Hrs		77
**High Temp. Storage Bake		150C, 500, 1000 Hrs		77
**Autoclave		121C, 96 Hrs		77
**T/C		-40C/125C, 250, 500, 1000 Cyc		77
Manufacturability (Assembly)		per mfg. Site specification		per spec
**Th/Shock		-40C/125C, 250, 500, 1000 Cyc		77
X-ray		top side only		5
Moisture Sensitivity		JEDEC L-3/260C		24
Notes: ** Preconditioning sequence. JEDEC L-3/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2011 年 2 月	終了	2011 年 5 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	DCR010505P	-	-	
Assembly Site:	HNT	Package/Code/Pins:	PDIP/NVE/7	
Mount Compound:	400018	Mold Compound:	450042	
Bond Wire:	1.2 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
**Steady-state Life Test	100C, 168, 500, 1000, 2000 Hrs		77	
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs		77	
Autoclave	121C, 96 Hrs		77	
**T/C	-40C/125C, 250, 500, 1000 Cyc		77	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		per spec	
**Th/Shock	-40C/125C, 250, 500, 1000 Cyc		77	
X-ray	top side only		5	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C		24	
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	ISO150AU	-	-	
Assembly Site:	HNT	Package/Code/Pins:	SOP/DBV/12	
Mount Compound:	400173	Mold Compound:	450042	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		79/0	
**T/C	-65C/150C, 1000 Cyc		80/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
X-ray	top side only		5/0	
Visual / Mechanical	-		50/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C		22/0	
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA2379AIDCN	-	-	
Assembly Site:	HNT	Package/Code/Pins:	SOT-23/DCN/8	
Mount Compound:	400154	Mold Compound:	450042	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 1000 Cyc		80/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
X-ray	top side only		5/0	
Visual / Mechanical	-		50/0	
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000hrs		78/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		22/0	
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-2/260C				